

請求の範囲

- [請求項1] 基材フィルム上に粘着剤層を有する半導体加工用粘着シートであって、
- 前記基材フィルムの5%モジュラスが7.0～20.0MPaであり、
- 前記基材フィルムが、1層であって、ベース樹脂100質量部に対してスチレン系ブロック共重合体5～39質量部を含み、
- 前記スチレン系ブロック共重合体が、スチレンー水添イソプレンースチレンブロック共重合体、スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体、スチレンー水添ブタジエンースチレンブロック共重合体およびスチレンー水添イソプレン／ブタジエンースチレンブロック共重合体から選択される少なくとも1種の樹脂であり、
- 前記ベース樹脂が、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖低密度ポリエチレン、エチレン・プロピレン共重合体、プロピレン共重合体、エチレンープロピレンージエン共重合体加硫物、ポリブテン、ポリブタジエン、ポリメチルペンテン、エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンー（メタ）アクリル酸共重合体、エチレンー（メタ）アクリル酸メチル共重合体、エチレンー（メタ）アクリル酸エチル共重合体、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、エチレンー塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリアミド、アイオノマー、ニトリルゴム、ブチルゴム、スチレンイソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、天然ゴムおよびその水添加物もしくは変性物から選択される少なくとも1種の樹脂であることを特徴とする半導体加工用粘着シート。
- [請求項2] 前記ベース樹脂が、ポリプロピレンであることを特徴とする請求項1に記載の半導体加工用粘着シート。
- [請求項3] 前記粘着剤層を形成する粘着剤が、アクリル系粘着剤であることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体加工用粘着シート。

- [請求項4] 前記スチレン系ブロック共重合体が、ベース樹脂 100 質量部に対して 10～35 質量部であることを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の半導体加工用粘着シート。
- [請求項5] 半導体パッケージのダイシングに用いられることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の半導体加工用粘着シート。